

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】令和 1 年 5 月 16 日 (2019.5.16)

【公開番号】特開 2018-101540 (P2018-101540A)

【公開日】平成 30 年 6 月 28 日 (2018.6.28)

【年通号数】公開・登録公報 2018-024

【出願番号】特願 2016-246915 (P2016-246915)

【国際特許分類】

H 0 1 R 13/52 (2006.01)

H 0 1 R 13/405 (2006.01)

【F I】

H 0 1 R 13/52 3 0 1 F

H 0 1 R 13/405

【手続補正書】

【提出日】平成 31 年 4 月 3 日 (2019.4.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 4】

図 4 に示すように、プレート 3 2 には、隔壁 3 1 b 側に凹部 3 2 d が形成されている。本実施形態において、プレート 3 2 には、4 つの凹部 3 2 d が形成されている。図 4 に示すように、隔壁 3 1 b には、プレート 3 2 の凹部 3 2 d と連通する貫通孔 3 1 X が形成されている。図 3 及び図 4 に示すように、貫通孔 3 1 X は、コネクタ 2 2 に配列された複数の端子 3 3 を避けるように形成されている。なお、図 4 に示すプレート 3 2 の凹部 3 2 d は、隔壁 3 1 b の貫通孔 3 1 X と連通して形成される。つまり、プレート 3 2 には 4 つの凹部 3 2 d が形成されている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 5】

これらの凹部 3 2 d は、ハウジング 3 1 を形成する工程において、プレート 3 2 の位置決めに用いられる。

図 6 に示すように、金型 5 0 は、上述のハウジング 3 1 (図 4 参照) の形成に用いられる。この金型 5 0 には、ピン状の位置決め部材 5 1 が立設されている。この位置決め部材 5 1 は、プレート 3 2 の凹部 3 2 d に挿入される。この位置決め部材 5 1 の挿入により、プレート 3 2 が金型 5 0 の内面 5 0 a から離間した状態で、プレート 3 2 が固定される。このプレート 3 2 と金型 5 0 の内面 5 0 a との隙間により、図 2 に示すハウジング 3 1 の隔壁 3 1 b が形成される。そして、ハウジング 3 1 を形成するために溶融された樹脂が金型 5 0 内に圧入される。このとき、プレート 3 2 の凹部 3 2 d に位置決め部材 5 1 が挿入されているため、この樹脂が圧入されたとき、中子つまりプレート 3 2 及び端子 3 3 は移動しない。そして、樹脂の硬化によりハウジング 3 1 が形成される。このため、ハウジング 3 1 の隔壁 3 1 b に、位置決め部材 5 1 に応じた貫通孔 3 1 X が形成される。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 7

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 2 7 】

コネクタ 2 2 の複数の端子 3 3 は、プレート 3 2 に対して圧入される。プレート 3 2 に対する複数の端子 3 3 の圧入は、複数の端子 3 3 を配列した状態で、自動機により行うことができる。このため、圧入のための時間は僅かである。このプレート 3 2 及び複数の端子 3 3 を中子としたインサート成形によりハウジング 3 1 が形成される。このため、複数の端子 3 3 を 1 本ずつ金型 5 0 に配設するインサート成形に比べ、僅かな時間で複数の端子 3 3 を金型 5 0 に配設することができる。このため、コネクタ 2 2 の形成に要する時間が短縮され、コネクタ 2 2 のコストが低減される。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 3 0

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 3 0 】

( 2 ) コネクタ 2 2 の複数の端子 3 3 は、プレート 3 2 に対して圧入される。プレート 3 2 に対する複数の端子 3 3 の圧入は、複数の端子 3 3 を配列した状態で、自動機により行うことができる。このため、圧入のための時間は僅かである。このプレート 3 2 及び複数の端子 3 3 を中子としたインサート成形によりハウジング 3 1 が形成される。このため、複数の端子 3 3 を 1 本ずつ金型 5 0 に配設するインサート成形に比べ、成型における手間が少なくなり、僅かな時間で複数の端子 3 3 を金型 5 0 に配設することができる。このため、成型における手間とコネクタ 2 2 の形成に要する時間を短縮することができ、コネクタ 2 2 のコストを低減することができる。